

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概要。由於此為概要，故其並未載有可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下在決定投資[編纂]前，務請細閱本文件全文。

任何投資均附帶風險。投資[編纂]的若干特有風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前，務請審慎細閱該節。

概覽

我們是誰

我們是一家領先的芯片定制解決方案上市公司，且擁有全面、專有的半導體IP組合。公司成立於2001年，總部位於上海，依託獨有的「芯片設計平台即服務」(「SiPaaS」)商業模式，提供芯片定制解決方案及半導體IP授權服務。我們作為連接半導體IP、設計服務和產業合作的重要生態角色，賦能全球客戶在AI時代高效開展創新。

根據灼識諮詢的資料，截至2025年12月31日，我們是處於第一梯隊的自主IP供應商，在數字IP、模擬及混合信號及射頻(「RF」)IP領域擁有最多的IP類別，並且按2025年IP收入計，我們是全球主要專注於數字IP的第二大半導體IP供應商。按2025年IP收入計，我們亦是中國內地最大的IP提供商，也是全球第八大IP提供商，及按2025年IP授權使用費收入計，為全球第六大IP提供商。

我們亦是行業先驅的芯片定制解決方案提供商，在交付複雜的系統級芯片(「SoC」)和系統級封裝(「SiP」)以及低能耗及具成本效益的芯片設計解決方案方面均擁有經市場驗證的卓越業績。根據灼識諮詢的資料，按2025年的收入計算，我們是全球第四大全棧芯片定制解決方案提供商，亦是中國內地最大的企業。截至2025年12月31日，我們已在包括4納米FinFET及22納米FD-SOI工藝節點在內的廣泛工藝節點上成功執行了眾多項目，這說明了我們IP和設計能力的廣度和深度。

商業模式

我們的商業模式反映了傳統半導體價值鏈的持續範式轉變。作為賦能內核，我們獨有的SiPaaS模式引領了全行業向「輕設計」的轉變。通過將豐富的自主半導體IP儲備與全方位的芯片定制能力深度融合，我們的客戶可將複雜的IC設計執行與量產環節交給我們處理。這極大地賦能了芯片公司(包括無晶圓廠芯片設計公司及垂直整合製造商(「IDM」))與系統廠商(互聯網廠商、雲服務提供商(「CSP」)、汽車廠商及原始設備製造商(「OEM」))，使其能夠聚焦於產品定義與核心架構創新，並顯著降低其營運開支。該模式亦幫助我們免受傳統芯片產品公司所經歷的內在周期性影響。

SiPaaS—芯片設計平台即服務

我們的核心業務模式為芯片設計平台即服務(SiPaaS)。該模式具備平台化、全方位、一站式服務(從規格定義到量產)的特徵，為我們構築了較高的競爭壁壘。

概 要

與傳統無晶圓廠芯片設計公司的模式不同，SiPaaS模式以我們豐富的自主半導體IP組合為核心，包括處理器IP及模擬及混合信號IP（包括射頻IP及接口IP）。通過對IP進行系統級優化，我們打造出靈活、可複用的設計平台。這不僅大幅降低了客戶的設計時間、成本與風險，還能為客戶提供從芯片定義、前端和後端設計、軟件設計到量產管理和交付的完整服務。

此外，區別於芯片公司，我們的SiPaaS模式不製造或銷售自有品牌芯片。我們專注通過深厚的技術積累提供芯片定制解決方案服務和半導體IP授權服務。



我們的收入來源於兩項高度協同的業務：

芯片定制解決方案服務

我們的芯片定制解決方案服務由以下兩個部分組成：

- **設計服務**：我們提供從規格定義到流片的芯片設計服務，產生非經常性工程收入。該服務包括架構定義、軟件設計、IP選擇與集成、RTL設計、驗證、物理實現以及原型製作等。我們的平台化模式使我們能夠複用過去的設計經驗，並將其應用於廣泛的客戶群體，從而大幅提升設計效率。
- **量產服務**：我們管理從晶圓製造到封裝、測試及物流的整個生產流程，並基於出貨量形成可規模化的量產服務收入。我們的量產服務亦具備可擴展性，在量產運營團隊規模相對固定的情況下，能夠應對量產規模的顯著增長。因此，我們的盈利能力亦隨著我們客戶產量的增加而有效擴大。

半導體IP授權服務

我們的半導體IP授權服務分為兩個階段：

- **IP授權使用費**：我們授予客戶在其芯片設計中使用公司IP的權利，並收取授權使用費收入。創建我們IP組合所需的大量成本乃預先產生並確認為研發開支。一旦經驗證，該等IP可以最低的增量成本重複授權。為順應日益增長的市場需求，我們預期高利潤的IP授權使用費收入將會改善我們的財務表現；

概 要

- **IP特許權使用費：**我們根據集成我們IP的芯片出貨數量收取IP特許權使用費，從而形成一個可擴展且隨客戶成功而增長的收入來源；隨著越來越多採用我們IP的設計進入量產，該等特許權使用費將日益為我們的盈利能力做出更大貢獻。

我們的收入在終端市場應用和客戶類型上均實現了多元化。我們提供的服務廣泛應用於多個應用領域，包括數據處理、消費電子、物聯網、計算機及周邊、工業及汽車電子。我們的客戶群包括芯片公司(無晶圓廠芯片設計公司及垂直整合製造商)及系統廠商(互聯網廠商、雲服務提供商、汽車廠商及其他OEM)。

從「芯片設計平台即服務」(SiPaaS)到「AI平台即服務」(AiPaaS)

我們的商業模式「芯片設計平台即服務」(SiPaaS)具有天然靈活性，不受任何特定應用領域的限制。隨著AI的普及，該模式自然延伸到AI專屬平台—即我們所稱的「AI平台即服務」(「AiPaaS」)；其中，SiPaaS仍然是平台的核心。

隨著向AI時代的轉型加速，我們為客戶提供：

- **豐富的AI處理器IP組合：**該組合以可擴展神經網絡處理器技術為核心，其架構旨在為各種AI工作負載提供高效計算。其功能這不僅包括針對大語言模型(「LLM」)及AIGC等生成式AI應用的優化，亦包括針對成熟的卷積模型及現實世界應用中複雜混合工作負載的優化。該基礎可實現一系列深度集成的AI賦能的IP，如AI-ISP、AI-Display及AI-DSP。我們亦已推出專注於高能效計算的創新型GPGPU架構，並已授權予整個生態系統中的多個參與者。

我們在該領域的服務基於：

- **深度集成的軟硬件協同設計以及芯片與封裝協同設計能力：**我們的軟硬件協同設計方法實現了芯片與軟件棧的並行開發，從而加快了設計週期。我們亦進行芯片與封裝協同設計，以確保最佳性能並減少後期修改。我們自有的創新片上硬件加速服務，針對各類複雜AI負載，極大優化定制芯片的性能、功耗、面積特性。同時，我們運用我們的Chiplet及下一代封裝工程能力，以應對異構計算日益複雜的要求，而異構計算在AI時代變得日益重要。
- **全面的AI ASIC定制服務：**涵蓋從芯片規格定義、前端與後端設計，到量產管理和交付的全部環節，提供高可靠性的全面交付流程，縮短客戶的研發週期。

依託上述核心能力，我們構建了我們的芯片定制解決方案，涵蓋：

- **雲計算平台：**專為數據中心及服務器中高能效、數據密集型處理而設計。
- **端側AI計算平台：**交付智能手錶和AI/AR眼鏡、AI玩具、AI戒指等「始終在線」的超低能耗、超輕量空間計算設備，以及AI PC、AI智能手機、智慧汽車和機器人等高能效端側計算設備。

概 要

AI ASIC帶來歷史性機遇

2022年ChatGPT的推出催生了計算需求的新時代，需要以高性能芯片為核心的大量AI基礎設施。為實現優於通用處理器的能效及更低的延遲，全球系統廠商正日益轉向專有的、針對AI的芯片定制解決方案，即「AI ASIC」。

我們已成功成為全球領先雲服務提供商的可信合作夥伴，同時也在新興端側AI市場積極佈局，包括存量市場AI智能手機、AI PC及AI Pad，以及增量市場AI/AR眼鏡、AI玩具、AI戒指和智慧汽車等。我們的AI相關IP組合已累積大量導入項目，而公司的財務表現也體現了這一戰略佈局。

全球戰略與生態

我們已建立全球研發與銷售網絡，截至2025年12月31日運營著九個研發中心(位於中國上海、成都、北京、南京、海口和廣州；美國硅谷和達拉斯及越南胡志明市)以及11個遍佈全球的銷售和客戶支持辦事處。這一戰略佈局使我們能夠吸引頂尖人才、提升研發效率，並為客戶提供高質量、本地化的服務。



附註：我們的全球佈局圖示

我們的收入結構也體現了我們的全球化佈局：我們的海外收入在2023年、2024年和2025年分別佔總收入的22.8%、37.5%和32.6%。我們還與領先的國際客戶(包括三星、谷歌、亞馬遜、微軟、百度、騰訊和阿里巴巴)保持著長期合作。我們與谷歌的戰略合作是我們端側AI戰略的一個里程碑。基於Open Se Cura開源項目，我們聯合開發了專為端側LLM打造的超低能耗Coral NPU IP。通過將谷歌的開源技術與我們的企業級IP和芯片定制解決方案服務相結合，Coral NPU為AI眼鏡、可穿戴設備和AI玩具以及類似應用提供了「始終在線、超低能耗、超輕量級」的計算底座。同時，我們已與全球領先的晶圓代工廠及封裝測試廠合作夥伴建立深厚、長期的合作關係，包括台積電、三星、中芯國際及格芯等晶圓代工廠，以及日月光科技、安靠科技、長電科技及通富微電等封裝測試廠。

我們通過戰略性的跨境收購加強了技術組合，例如來自LSI Logic的DSP部門(2006年，奠定我們DSP IP的基礎)和Vivante Corporation(2016年，為我們的IP組合增添了市場領先的高性能且高能效GPU IP)。我們致力於國際標準與開放合作。我

概 要

們積極參與並共建全球及國內產業組織，包括中國RISC-V產業聯盟(CRVIC)、上海開放處理器產業創新中心(SOPIC)、RISC-V International、OpenHW Group、Chips Alliance以及UCIe聯盟。

財務表現

受益於我們獨特的商業模式，我們在往績記錄期內實現了強勁的財務表現。我們的收入在2023年、2024年和2025年分別為人民幣23億元、人民幣23億元和人民幣31億元，其中2025年錄得35.9%的顯著同比增長。2025年下半年，我們的收入達人民幣22億元，較2024年下半年增長56.8%，較2025年上半年增長124.3%。

我們2025年第二、第三和第四季度的新簽訂單分別達到人民幣12億元、人民幣16億元和人民幣27億元，三次打破我們單季度新簽訂單的歷史紀錄。值得注意的是，我們2025年第四季度的新簽訂單較第三季度增長了70.2%。2025年，新簽訂單總額為人民幣60億元，同比增長103.4%。在該等新簽訂單中，AI算力相關訂單佔比超過73%，數據處理終端市場訂單佔比超過50%，主要由雲側AI ASIC及IP的需求驅動。

截至2025年12月31日，我們的在手訂單達到人民幣51億元，較截至2025年9月30日的人民幣33億元大幅增加54.5%，較截至2024年12月31日的人民幣24億元增加111.0%。該指標已連續九個季度保持在高位。在我們截至2025年12月31日的在手訂單中，量產服務超過人民幣30億元。根據構成我們在手訂單的合約條款，我們預計截至2025年12月31日的在手訂單中超過80%將在一年內轉化為收入，而截至2025年12月31日的在手訂單中近60%來自數據處理終端市場，主要由雲側AI ASIC及IP的需求驅動。

根據灼識諮詢的資料，IC設計行業具有投資週期長和研發支出龐大的特點。我們堅持維持高研發投入以構建高競爭壁壘，確保我們在半導體IP和定制芯片領域具備領先的芯片設計和技術研發能力。於往績記錄期間的淨虧損，系公司對研發進行主動、戰略性投入所致；在2022至2023年半導體行業下行周期中，公司預判生成式人工智能(Generative AI)的興起將為定制集成電路(IC)釋放巨大潛力，因此戰略性加大校園招聘以維持並擴充研發人才儲備，且未實施裁員以保持競爭優勢。於往績記錄期內，我們持續在研發上進行大量投資。在2023年、2024年和2025年，我們的研發費用分別佔我們收入的40.7%、53.8%和41.7%。這些基礎性的投入，對於強化我們全面的半導體IP組合以及構建從規格定義到量產的定制芯片能力至關重要，既構築了較高的行業進入壁壘，也為我們在AI時代實現長期增長奠定了基礎。隨著我們穩健的訂單轉化為執行，我們過往投入的研發開支正逐步部署於客戶項目並產生輸出，推動我們的研發費用率呈現合理的下降趨勢。從2024年到2025年，我們的研發費用佔收入的百分比下降了12.1%，顯示出我們的運營效率持續優化及規模經濟效應的顯現。

研發

我們的研發活動主要受市場趨勢及客戶需求驅動，重點關注處理器IP、IP子系統、模擬與混合信號IP(包括射頻IP及接口IP)及軟件平台，以及支持在我們SiPaaS商業模式下交付定制設計項目的關鍵設計方法。憑藉該等研發驅動的能力，我們得以應用先進製造工藝及封裝，從而支持在SiPaaS業務模式下交付定製設計項目。截至2025年12月31日，我們已在九個城市(包括中國內地及海外地點)設立研發中心，這使我們能夠將新開發及領先的技術融入我們的研發項目中。

銷售及營銷

我們已建立全球銷售及營銷平台，以支持我們的業務增長並深化我們與關鍵客戶的合作。我們在主要客戶所在的多個地點設有銷售及技術支持中心，包括

概 要

中國、美國、歐洲、日本及韓國。該網絡使我們能夠密切監控市場動態及客戶需求，並在我們的目標市場有效推廣及交付我們的服務。

我們的區域銷售團隊與技術支持團隊緊密協調，為客戶提供及時、本地化的支持。透過這種集成的銷售及技術支持模式，我們旨在提高對客戶請求的響應速度，提升客戶滿意度，並與我們關鍵市場的領先行業參與者建立長期的戰略關係。

客戶及供應商

我們的客戶

我們的客戶主要包括芯片公司(包括無晶圓廠設計公司及垂直整合製造商)及系統廠商(包括互聯網廠商、雲服務提供商、汽車廠商及其他OEM)。截至2025年12月31日，我們的芯片定制解決方案服務已服務約350名客戶，而我們的IP授權服務已服務超過465名客戶。於2023年、2024年及2025年，對我們五大客戶的銷售額分別為人民幣1,086.7百萬元、人民幣1,033.0百萬元及人民幣1,434.3百萬元，分別佔我們各年總收入的46.7%、44.6%及45.6%。於2023年、2024年及2025年，對我們最大客戶的銷售額分別為人民幣535.1百萬元、人民幣469.2百萬元及人民幣503.9百萬元，分別佔我們各年總收入的23.0%、20.3%及16.0%。

我們的供應商

我們的主要供應商主要包括晶圓代工廠、封裝測試廠及IP/EDA供應商。於2023年、2024年及2025年，向我們五大供應商的採購額分別為人民幣656.7百萬元、人民幣803.8百萬元及人民幣1,297.6百萬元，分別佔我們各年總採購額的73.6%、67.2%及67.7%。於2023年、2024年及2025年，向我們最大供應商的採購額分別為人民幣264.3百萬元、人民幣213.8百萬元及人民幣546.1百萬元，分別佔我們各年總採購額的29.6%、17.9%及28.5%。

我們的競爭優勢

我們相信以下優勢使我們處於有利位置，可把握未來行業機遇並實現持續增長：

- 放大協同效應並提供結構性優勢的獨特SiPaaS業務模式
- 我們先進且全面的半導體IP組合
- 從規格定義到量產的強大芯片定制能力
- 在整個產業鏈中擁有強大且不斷擴張的行業生態合作夥伴的全球佈局
- 持續的研發投入推動創新與技術進步
- 經驗豐富的管理團隊與可持續的人才文化

我們的增長戰略

我們擬鞏固我們作為一家領先的上市芯片定制解決方案服務提供商的地位。為實現此目標，我們計劃採取以下策略：

- 從IP到AI賦能的IP
- 從SoC到SiP
- 從雲側AI ASIC到端側AI ASIC

概 要

- 深化全球生態系統合作
- 持續投資人才，積極履行企業社會責任
- 推進併購與戰略投資

競爭

我們服務的市場競爭激烈，其特徵為技術快速變革、行業標準不斷演進及客戶需求不斷變化。我們的客戶及潛在客戶亦尋求管理其整體設計成本，並可能將其採購集中於少數供應商。我們與其他半導體IP及設計服務提供商，以及在內部開發IP或承擔設計工作的半導體公司的內部工程團隊競爭。隨著我們營運所在市場的不斷發展，我們預期現有競爭對手將增加投資，並將出現新的市場參與者。有關我們競爭格局的詳情，請參閱「行業概覽」。

過往財務資料概要

下表載列我們於往績記錄期間的綜合財務資料的概要財務數據。下文所載的概要財務數據應連同本文件附錄一會計師報告所載的綜合財務報表(包括相關附註)一併閱讀，並須經參考該等資料而受其全文規限。我們的綜合財務資料已根據國際財務報告準則會計準則編製。

經營業績

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
			(千元，百分比除外)			
收入	2,328,953	100.0	2,316,976	100.0	3,148,403	100.0
銷售成本	(1,289,294)	(55.4)	(1,392,953)	(60.1)	(2,074,688)	(65.9)
毛利	1,039,659	44.6	924,023	39.9	1,073,715	34.1
其他收入	66,859	2.9	61,380	2.6	63,997	2.0
其他收益及虧損	(405)	(0.0)	19,586	0.8	12,239	0.4
研發(「研發」)開支	(947,223)	(40.7)	(1,247,302)	(53.8)	(1,312,692)	(41.7)
行政開支	(121,771)	(5.2)	(125,381)	(5.4)	(147,006)	(4.7)
銷售及營銷開支	(114,853)	(4.9)	(119,983)	(5.2)	(127,208)	(4.0)
其他開支	(10,079)	(0.4)	(8,727)	(0.4)	(7,929)	(0.3)
預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)模式下的減值虧損(扣除撥回)	(125,475)	(5.4)	(43,627)	(1.9)	(27,144)	(0.9)
應佔聯營公司業績	(32,757)	(1.4)	(5,686)	(0.2)	113	0.0
融資成本	(23,179)	(1.0)	(36,166)	(1.6)	(41,355)	(1.3)
除稅前虧損	(269,224)	(11.5)	(581,883)	(25.2)	(513,270)	(16.4)
所得稅開支	(27,243)	(1.2)	(18,996)	(0.8)	(14,543)	(0.5)
年度虧損	(296,467)	(12.7)	(600,879)	(26.0)	(527,813)	(16.9)

概 要

非國際財務報告準則計量

為補充我們根據國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，我們亦使用若干非國際財務報告準則計量(包括經調整年內淨虧損(非國際財務報告準則計量)及經調整EBITDA(非國際財務報告準則計量))作為額外財務計量，而該等計量並非國際財務報告準則所規定或根據其呈列。我們相信，該等計量為投資者及其他人士理解及評估我們的綜合經營業績提供有用資料，其方式與我們的管理層評估我們的經營表現及制定業務計劃的方式一致。然而，我們的經調整年內淨虧損(非國際財務報告準則計量)及經調整EBITDA(非國際財務報告準則計量)可能無法與其他公司呈列的類似名稱的計量相比較。使用該等非國際財務報告準則計量作為分析工具有其局限性，閣下不應孤立地考慮該等計量，或將其作為根據國際財務報告準則報告的我們的經營業績或財務狀況分析的替代品。

經調整年內淨虧損(一項非國際財務報告準則計量)的定義為年度虧損，經調整以加回股份支付薪酬的影響。經調整EBITDA(一項非國際財務報告準則計量)的定義為年度虧損，經調整以加回(i)股份支付薪酬、(ii)利息開支、(iii)折舊及攤銷以及(iv)所得稅開支的影響。

下表載列經調整年內淨虧損(一項非國際財務報告準則計量)及經調整EBITDA(一項非國際財務報告準則計量)與國際財務報告準則計量的年度虧損的對賬，以絕對金額及佔收入百分比呈列。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
			(千元，百分比除外)			
經調整年內淨虧損						
年度虧損.....	(296,467)	(12.7)	(600,879)	(26.0)	(527,813)	(16.9)
經以下項目調整：						
股份支付薪酬	3,605	0.2	7,290	0.3	41,613	1.3
經調整年內淨虧損 ..	(292,862)	(12.5)	(593,589)	(25.7)	(486,200)	(15.6)
經調整EBITDA						
年度虧損.....	(296,467)	(12.7)	(600,879)	(26.0)	(527,813)	(16.9)
經以下項目調整：						
股份支付薪酬	3,605	0.2	7,290	0.3	41,613	1.3
利息開支.....	23,179	1.0	36,166	1.6	41,355	1.3
折舊及攤銷.....	185,989	8.0	239,841	10.4	266,350	8.5
所得稅開支.....	27,243	1.2	18,996	0.8	14,543	0.5
經調整EBITDA	(56,451)	(2.3)	(298,586)	(12.9)	(163,952)	(5.3)

收入

我們提供芯片定制解決方案服務及IP授權服務。在我們的芯片定制解決方案服務下，我們承擔從芯片設計到量產的全部或部分流程，並提供相關的軟件設計服務。我們亦透過將我們的IP作為單個IP或IP平台單獨授權予客戶，提供半導體IP授權服務。

概 要

按服務劃分

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
			(千元，百分比除外)			
芯片定制解決方案						
服務						
設計服務.....	492,470	21.1	724,794	31.3	876,558	27.9
量產服務.....	1,071,416	46.0	856,214	37.0	1,489,681	47.3
小計.....	1,563,886	67.1	1,581,008	68.2	2,366,239	75.2
半導體IP授權服務						
IP授權使用費....	655,375	28.1	632,859	27.3	671,253	21.3
IP特許權使用費..	109,692	4.7	103,109	4.5	110,911	3.5
小計.....	765,067	32.9	735,968	31.8	782,164	24.8
總計.....	2,328,953	100.0	2,316,976	100.0	3,148,403	100.0

按終端應用劃分

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
			(千元，百分比除外)			
數據處理.....	314,718	13.5	552,201	23.8	1,078,735	34.3
消費電子.....	513,007	22.0	484,939	20.9	676,157	21.5
物聯網.....	961,432	41.3	642,553	27.7	659,092	20.9
計算機及周邊.....	197,413	8.5	323,891	14.0	308,406	9.8
工業.....	185,718	8.0	98,254	4.3	216,705	6.9
汽車電子.....	156,665	6.7	215,138	9.3	209,308	6.6
總計.....	2,328,953	100.0	2,316,976	100.0	3,148,403	100.0

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
			(千元，百分比除外)			
AI.....	1,007,075	43.2	1,295,363	55.9	2,030,989	64.5
非AI.....	1,321,878	56.8	1,021,613	44.1	1,117,414	35.5
總計.....	2,328,953	100.0	2,316,976	100.0	3,148,403	100.0

概 要

毛利及毛利率

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率 ⁽¹⁾
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(千元，百分比除外)					
芯片定制解決方案						
服務						
設計服務.....	70,720	14.4	93,298	12.9	124,652	14.2
量產服務.....	293,939	27.4	165,209	19.3	270,248	18.1
小計.....	364,659	23.3	258,507	16.4	394,900	16.7
半導體IP授權服務						
IP授權使用費....	572,957	87.4	567,763	89.7	575,744	85.8
IP特許權使用費..	109,692	100.0	103,109	100.0	110,911	100.0
小計.....	682,649	89.2	670,872	91.2	686,655	87.8
計入銷售成本的存貨						
撇減.....	(3,548)		(1,747)		(3,451)	
計入銷售成本的附加						
費及其他稅項....	(4,101)		(3,609)		(4,389)	
總計/平均.....	1,039,658	44.6	924,023	39.9	1,073,715	34.1

附註：

(1) 整體毛利率按年內毛利除以相應年度的收入再乘以100%計算。

請參閱「財務資料—經營業績的同比比較」。

綜合財務狀況表概要

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣	人民幣	人民幣
	(千元)		
非流動資產.....	1,688,437	1,991,663	2,031,423
流動資產.....	2,717,944	2,638,196	5,686,135
流動負債.....	949,996	1,547,239	2,526,694
流動資產淨值.....	1,767,948	1,090,957	3,159,441
資產總值減流動負債.....	3,456,385	3,082,620	5,190,864
非流動負債.....	756,092	960,302	1,773,358
資產淨值.....	2,700,293	2,122,318	3,417,506
權益總額.....	2,700,293	2,122,318	3,417,506

請參閱「財務資料—綜合財務狀況表選定項目」。

概 要

現金流量

下表載列我們於所示年度的現金流量。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
經營活動所用現金淨額.....	(8,523)	(345,990)	(221,686)
投資活動(所用)／所得現金淨額..	(426,196)	46,526	(1,023,179)
融資活動所得現金淨額.....	356,581	248,131	2,610,893
現金及現金等價物(減少)／ 增加淨額.....	(78,138)	(51,333)	1,366,028
年初現金及現金等價物.....	761,884	685,253	642,835
外匯匯率變動的影響淨額.....	1,507	8,915	(2,438)
年末現金及現金等價物.....	685,253	642,835	2,006,425

請參閱「財務資料－現金流量」。

主要財務比率

下表載列我們於所示年度或日期的主要財務比率。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
收入同比增長 ⁽¹⁾	(12.9)%	(0.5)%	35.9%
研發費用率 ⁽²⁾	40.7%	53.8%	41.7%
毛利率 ⁽³⁾	44.6%	39.9%	34.1%
經調整虧損率 ⁽⁴⁾	(12.5)%	(25.7)%	(15.6)%
經調整EBITDA利潤率 ⁽⁵⁾	(2.3)%	(12.9)%	(5.3)%
資產負債率 ⁽⁶⁾	17.1%	24.7%	20.3%

附註：

- (1) 收入同比增長按本年度與上一年度的收入變動除以上一年度的收入再乘以100%計算。
- (2) 研發費用率按年內研發開支除以相應年度的收入再乘以100%計算。
- (3) 毛利率按年內毛利除以相應年度的收入再乘以100%計算。
- (4) 經調整虧損率按經調整年內淨虧損除以相應年度的收入再乘以100%計算。亦請參閱「非國際財務報告準則計量」。
- (5) 經調整EBITDA利潤率按年內經調整EBITDA除以相應年度的收入再乘以100%計算。亦請參閱「非國際財務報告準則計量」。
- (6) 資產負債率按於相應年度末的總借款除以總資產計算。

概 要

[編纂]開支

[編纂]開支指就[編纂]及[編纂]產生的專業費用、[編纂]及費用。於往績記錄期間，我們並無產生任何[編纂]開支。

我們的[編纂]開支估計約為[編纂]百萬港元(包括[編纂]佣金)，佔[編纂][編纂]總額的[編纂]% (假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，且[編纂]未獲行使)。在我們的[編纂]開支中，約[編纂]百萬港元直接歸屬於H股的[編纂]，並將於[編纂]完成後計入權益，而約[編纂]百萬港元已經或將計入我們的綜合損益及其他全面收益表。我們於往績記錄期間產生及預期產生的[編纂]開支將包括約[編纂]百萬港元的[編纂]相關開支及費用(包括但不限於[編纂]及費用)、約[編纂]百萬港元的法律顧問及申報會計師的非[編纂]相關開支及費用，以及約[編纂]百萬港元的其他非[編纂]相關費用及開支。於往績記錄期間，我們並無產生任何[編纂]開支。上述[編纂]開支為最新可行估計，僅供參考，實際金額可能與此估計不同。

風險因素

我們面臨的風險包括「風險因素」一節所載列者。由於不同投資者在釐定風險的重要性時可能有不同的詮釋及標準，閣下在決定投資於我們的H股前，應細閱「風險因素」一節全文。我們面臨的部分主要風險包括：

- 我們面臨激烈的競爭，未來可能面臨更大的競爭壓力。倘我們未能有效競爭，我們的業務、收益增長及經營業績可能會受到重大不利影響。
- 對我們的服務的需求主要取決於半導體行業的趨勢，其受快速的技術變革以及我們客戶及終端客戶的需求影響。
- 我們依賴與行業參與者的關係，任何無法發展或維持該等關係的情況均可能對我們的競爭力產生不利影響。
- 我們的收益可能受到定價壓力、客戶集中度及服務生命週期動態的影響，因此可能低於預期。
- 我們面臨與客戶集中度相關的風險以及與客戶需求及其履行合約義務相關的風險。

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除與[編纂]有關的[編纂]及其他估計開支後，我們估計將從[編纂]中獲得約[編纂]百萬港元的[編纂]淨額(假設[編纂]未獲行使)。我們擬按下列用途及金額使用[編纂]。

- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元)將用於投資關鍵技術及核心業務的研發。
- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元)將用於進一步發展我們的全球營銷網絡。
- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元)將用於戰略投資及／或收購。
- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

概 要

[編纂]統計數據

下表的統計數據乃基於以下假設：(i)[編纂]已完成及[編纂]股H股於[編纂]中獲新[編纂]；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)概無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份：

	按每股H股 [編纂] [編纂]港元 計算	按每股H股 [編纂] [編纂]港元 計算
H股[編纂] ⁽¹⁾	[編纂] 百萬港元	[編纂] 百萬港元
本公司總市值 ⁽²⁾	[編纂] 百萬港元	[編纂] 百萬港元
每股未經審核[編纂]經調整有形資產 淨值 ⁽³⁾⁽⁴⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) H股[編纂]的計算乃基於緊隨[編纂]完成後預期將發行的[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) 本公司市值的計算乃基於截至最後實際可行日期已發行的525,915,273股A股(不包括我們作為庫存股持有的287,000股A股)及緊隨[編纂]完成後預期將發行的[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)。A股[編纂]乃按A股於緊接最後實際可行日期前五個營業日的平均收市價每股人民幣200.66元計算。
- (3) 每股未經審核[編纂]經調整有形資產淨值乃經作出本文件「附錄二—未經審核[編纂]財務資料」所指的調整後得出。
- (4) 並無作出調整以反映我們於2025年12月31日後訂立的任何交易結果或其他交易。

股息

任何建議的股息分派均應由我們的董事會制定，並須經我們的股東批准。未來宣派或派付任何股息的決定以及任何股息的金額，將取決於多項因素，包括我們的盈利及財務狀況、營運要求、資本要求、業務前景、有關宣派及派付股息的監管規定，以及我們的董事可能認為重要的任何其他因素。

無法保證任何年度將宣派或派付任何金額的股息。截至最後實際可行日期，我們並無任何預先釐定的派息率。根據我們的組織章程細則以及中國公司法及《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》，我們已通過一項一般股息政策，據此，倘符合分派股息的條件，我們可通過現金股息、股票股息或現金與股票股息相結合的方式宣派股息。經我們的中國法律顧問告知，根據中國公司法的規定，本公司僅可於彌補虧損及計提儲備金後，以剩餘稅後利潤分派股息。我們將根據適用的中國法律及我們的組織章程細則派付股息。

概 要

我們於上海證券交易所科創板上市

自2020年8月起，本公司A股已於上海證券交易所科創板上市。截至最後實際可行日期，我們的董事確認，我們在任何重大方面概無不遵守上海證券交易所科創板規則及中國其他適用證券法律法規的情況，且據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無有關我們在上海證券交易所科創板的合規記錄而須提請投資者垂注的重大事宜。我們的中國法律顧問告知我們，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無受到中國證監會或其派出機構或上海證券交易所施加的任何重大行政處罰或監管措施，且我們已在所有重大方面遵守適用於我們的A股上市相關中國法律法規。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並無注意到任何事宜會令彼等不同意我們的董事就本公司於上海證券交易所科創板的合規記錄作出的確認。

近期發展

2026年1月，我們完成了對逐點半導體的收購。請參閱「歷史、發展及公司架構—重大收購、出售及合併—收購逐點半導體」。

無重大不利變動

我們的董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況自2025年12月31日以來並無重大不利變動，且自2025年12月31日以來並無發生任何將對本文件附錄一會計師報告所載資料構成重大影響的事件。